公司代码：688125　　公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在 2023 年年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至本报告披露日，公司总股本为 80,808,080 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，以此计算拟合计派发现金红利 12,121,212 元(含税)。2023 年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润 29,166,981.42 元的比例为 41.56%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，亦不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分配总额，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨明辉	陈珊
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号	广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
电话	0755-86544020	0755-86544020
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球电子行业头部客户及产业链 EMS 客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司产品主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机、等离子清洗机、固化炉、ADA 智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

(1)流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机和喷墨机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的 SMT 电子装联段、FATP 后段组装的底部填充、围坝、引脚封装、堆栈封装 POP、补强、三防涂覆等工艺，以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
点胶机	AD系列（在线）	AD-IG系列智能精密点胶机	1.用途：用于消费电子产品、半导体产品等SMT段点胶工艺，底部填充、封装围坝、IC补强、IC底固机械、封装加盖工序。 2.产品特点：双轨采用直线导轨，运动精度更高；搭载CCD视觉系统，可实现胶点、点相对定、引脚等识别，可满足不同产品点胶需求，保证点胶质量稳定。
			1.用途：适用于3C、汽车电子、MiniLED等行业中元器件底部填充、引脚加固、点固后点胶等工艺。 2.产品特点：工作区域较大点胶阀可选配双/三/四点胶阀，可同时点胶，提升产能；可实现点胶轨迹、点胶量、点胶速度等参数灵活调整，满足多样化工艺需求。
		Dot-IM/IH/IL系列 智能点胶机	
	Dot系列（在线）	Dot-IM/IH/IL系列 智能精密点胶机	1.用途：适用于3C、汽车电子、新能源等大型产品点胶机，如点引脚固定、表面加强、补强、FPC/元件定位等工艺。 2.产品特点：具备较大点胶工作区域，最大可达800mm；可进行双轨工作点胶，提高效率；搭载CCD视觉系统，灵活定位补强；可实现生产信息追溯，提升品质管控。
	Dot-510/511系列 智能精密点胶机		1.用途：适用于3C、汽车电子、半导体封装等行业上点胶工艺（如指纹片点胶、点固、点胶封装、点胶填充、BGA封装、排线等）。 2.产品特点：主要或辅助点胶；可选搭配二维或三维点胶平台，满足多点、多轨、多点胶、点胶轨迹等多样化工艺需求；搭载CCD视觉系统，可实现定位、检测、点胶轨迹规划等功能。ADI系列可选配点胶阀或开放式喷涂模组。
	15W-2000/3000系列 桌面点胶机		1.用途：热固胶粘接、底部填充、引脚加固、焊接点涂POP、固定点填充、点胶封装、FPC元器件引脚定位。 2.产品特点：设备有多种点胶阀设备，可满足多种需求，与机台间设计、采用结构模块化，可快速切换。
	ADC系列（在线）	ADC-5D五轴联动点胶机	1.用途：热固胶粘接、底部填充、引脚加固、焊接点涂POP、固定点填充、点胶封装、FPC元器件引脚定位。 2.产品特点：(1)底座直线电机+运动控制卡，提升了动态定位精度；(2)上下加热模组，实现产品多点同时点胶或点涂封装；(3)可适配多个点胶阀的每片机应用，也可单独编制点胶轨迹；(4)通过AI算法实现产品检测定位，上料采用自动取放模组和输送线，实现全自动生产；(5)可选配摄像头，上料后检测点胶质量，如点胶量、位置、形状等。
涂覆机	iCoat系列	iCoat-5和喷涂模组	1.工作台：适用于多种工作模式下，可实现多类型涂覆，如行程模式、多轨模式、多轨模式等工艺。 2.产品特点：可实现不规则图形涂覆，可配备多种喷枪，适用多种涂料，满足涂料特性要求。
		iCoat-5和喷涂模组	1.用途：适用于3C、汽车电子、MiniLED等行业中元器件底部填充、引脚加固、点固后点胶等工艺。 2.产品特点：工作区域较大点胶阀可选配双/三/四点胶阀，可同时点胶，提升产能；可实现点胶轨迹、点胶量、点胶速度等参数灵活调整，满足多样化工艺需求。
		iCoat-5和喷涂模组	1.用途：适用于3C、汽车电子、MiniLED等行业中元器件底部填充、引脚加固、点固后点胶等工艺。 2.产品特点：工作区域较大点胶阀可选配双/三/四点胶阀，可同时点胶，提升产能；可实现点胶轨迹、点胶量、点胶速度等参数灵活调整，满足多样化工艺需求。
灌胶机		灌胶机	1.用途：适用于消费电子、汽车电子、新能源、工业三化等领域的智能模块SMT段灌封工艺，如：灌封、填充工艺、点胶工艺、封装工艺、灌胶工艺、灌胶工艺、灌胶工艺、灌胶工艺。 2.产品特点：适应多种灌封材料的要求，可实现灌封材料的精确计量、混合、均匀、脱泡、固化、灌封等多种工艺。

(2)等离子设备

等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机，用于清洗 FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。

产品系列	典型产品图示	产品性能
VP系列	VP-10L在线式真空等离子清洗机	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件表面有机物，去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：真空腔体采用合金铝制成，抽真空时间短达秒，腔真空时间短达秒；输送机构采用伺服电机，实现高速高精度；可实现高温清洗，温度最高达40度，并在真空环境下可实现超细纳米级真空粗化效应。
	VP-60/80系列全自动高速式真空等离子清洗机	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件表面有机物，去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：真空腔体采用不锈钢材质成型，抽真空时间短达秒，腔真空时间短达秒；可实现高温清洗，温度最高达40度；适用于等离子体工艺进入超细纳米级真空粗化效应。
AP系列	AP-7660等离子清洗机	1.用途：对产品表面灵敏不耐受的FPC、PCB、手机零部件等表面有机物进行清洗，提高表面附着力。 2.产品特点：清洗速度快、效率高，实现连续生产和批量作业；采用真空等离子清洗机可实现无污染、低气压、更加环保、可实现无接触气体激活；清洗成本低。
SDG-APR	SDG-APR 全自动等离子清洗机	1.用途：适用于手机配件、手机、电脑、照相机、汽车、金属等工业产品的三防涂覆工艺和清洗，有机物清洗和去静电，提高表面附着力。 2.产品特点：适用于高附加值的贵重材料，保证清洗效果的稳定性；采用真空等离子清洗机可实现无污染、无接触、无静电、无残留；清洗成本低。

(3)固化及智能组装设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件或产品贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA 智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁付、视觉检测等。ADA 智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
固化设备	红外固化	iCure-20系列红外固化炉	1.用途：用于热固型水油漆后的红外固化工艺。 2.产品特点：采用烘干室结构，隔板效果好；[illegible]；搭载高效红外管，[illegible]，节能高效。
	紫外固化	UV-LED的紫外固化机	1.用途：适用于点胶、点胶后的固化、点胶后的检测、点胶后的检测、点胶后的检测、点胶后的检测。 2.产品特点：具有选择点胶点胶模组、点胶模组、点胶模组、